



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: **WBG 半导体表面激活键合与全金属 3D 互连技术研究进展**

演讲人:Tadatomo SUGA 东京大学名誉教授 明星大学教授

演讲人简介:

Tadatomo SUGA 教授于 1979 年加入 Max-Planck Institut für Metallforschung, 1983 年获得斯图加特大学材料科学博士学位。自 1984 年以来,他一直是东京大学的教员,自 1993 年起担任工程学院精密工程系的教授。他还曾担任国立材料科学研究所(NIMS)互连生态设计研究小组主任、日本科学理事会成员、IEEE CPMT 学会日本分会主席,以及日本电子封装研究所(JIEP)主席。

他的研究重点是微系统集成和封装,并开发互连技术,特别是用于 3D 集成的室温键合技术。他致力于在工业界和学术界之间创建包装技术合作,指导微系统集成研究所(IMSI)的研发项目,并作为国际生态设计会议的主要组织者,倡导包装技术环境方面的重要性。

2019 年 3 月,他从东京大学退休,加入明星大学继续他的研究。